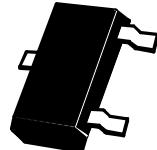
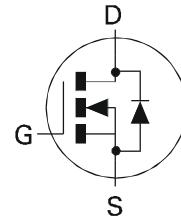


30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET**SUMMARY****V_{(BR)DSS}=30V; R_{D(S(ON))}=0.22Ω; I_D=1.4A****DESCRIPTION**

This new generation of high density MOSFETs from Zetex utilises a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed. This makes them ideal for high efficiency, low voltage, power management applications.

**SOT23****FEATURES**

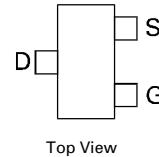
- Low on-resistance
- Fast switching speed
- Low threshold
- Low gate drive
- SOT23 package

**APPLICATIONS**

- DC - DC Converters
- Power Management Functions
- Disconnect switches
- Motor control

ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE (inches)	TAPE WIDTH (mm)	QUANTITY PER REEL
ZXM61N03FTA	7	8mm embossed	3000 units
ZXM61N03FTC	13	8mm embossed	10000 units



Top View

DEVICE MARKING

- N03

ZXM61N03F

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

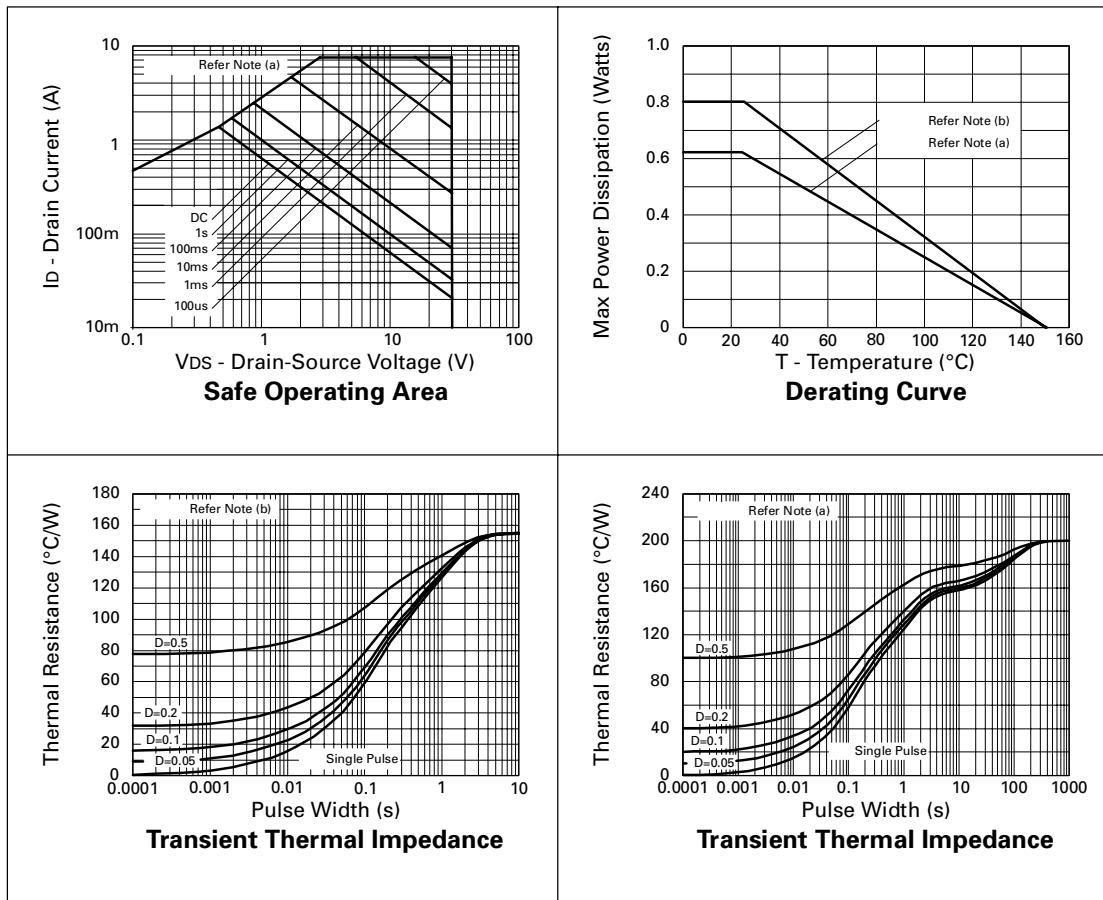
PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-Source Voltage	V _{DSS}	30	V
Gate Source Voltage	V _{GS}	±20	V
Continuous Drain Current (V _{GS} =10V; T _A =25°C)(b) (V _{GS} =10V; T _A =70°C)(b)	I _D	1.4 1.1	A
Pulsed Drain Current (c)	I _{DM}	7.3	A
Continuous Source Current (Body Diode) (b)	I _S	0.8	A
Pulsed Source Current (Body Diode)	I _{SM}	7.3	A
Power Dissipation at T _A =25°C (a)	P _D	625	mW
Linear Derating Factor		5	mW/°C
Power Dissipation at T _A =25°C (b)	P _D	806	mW
Linear Derating Factor		6.4	mW/°C
Operating and Storage Temperature Range	T _j ;T _{stg}	-55 to +150	°C

THERMAL RESISTANCE

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to Ambient (a)	R _{θJA}	200	°C/W
Junction to Ambient (b)	R _{θJA}	155	°C/W

NOTES

- (a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions
- (b) For a device surface mounted on FR4 PCB measured at t≤5 secs.
- (c) Repetitive rating - pulse width limited by maximum junction temperature. Refer to Transient Thermal Impedance graph.

CHARACTERISTICS

ZXM61N03F

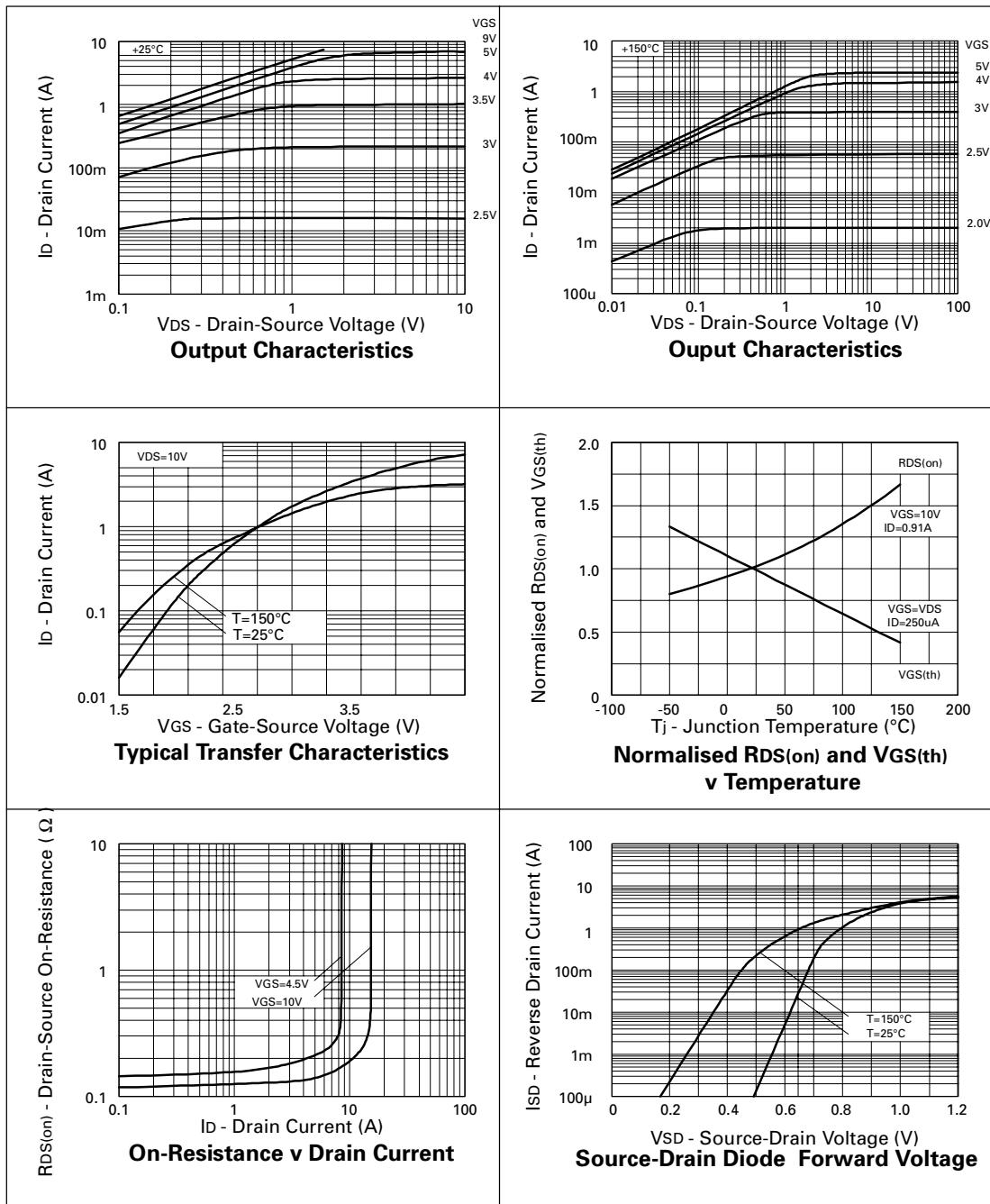
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at TA = 25°C unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.(3)	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
STATIC						
Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	30			V	I _D =250μA, V _{GS} =0V
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}			1	μA	V _{DS} =30V, V _{GS} =0V
Gate-Body Leakage	I _{GSS}			100	nA	V _{GS} =±20V, V _{DS} =0V
Gate-Source Threshold Voltage	V _{GS(th)}	1.0			V	I _D =250μA, V _{DS} = V _{GS}
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	R _{DS(on)}			0.22 0.30	Ω	V _{GS} =10V, I _D =0.91A V _{GS} =4.5V, I _D =0.46A
Forward Transconductance (3)	g _{fs}	0.87			S	V _{DS} =10V, I _D =0.46A
DYNAMIC (3)						
Input Capacitance	C _{iss}		150		pF	
Output Capacitance	C _{oss}		35		pF	V _{DS} =25 V, V _{GS} =0V, f=1MHz
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}		15		pF	
SWITCHING(2) (3)						
Turn-On Delay Time	t _{d(on)}		1.9		ns	
Rise Time	t _r		2.5		ns	
Turn-Off Delay Time	t _{d(off)}		5.8		ns	V _{DD} =15V, I _D =0.91A R _G =6.2Ω, R _D =16Ω (refer to test circuit)
Fall Time	t _f		3.0		ns	
Total Gate Charge	Q _g			4.1	nC	
Gate-Source Charge	Q _{gs}			0.4	nC	V _{DS} =24V, V _{GS} =10V, I _D =0.91A (refer to test circuit)
Gate-Drain Charge	Q _{gd}			0.63	nC	
SOURCE-DRAIN DIODE						
Diode Forward Voltage (1)	V _{SD}			0.95	V	T _J =25°C, I _S =0.91A, V _{GS} =0V
Reverse Recovery Time (3)	t _{rr}		11.0		ns	T _J =25°C, I _F =0.91A, di/dt= 100A/μs
Reverse Recovery Charge (3)	Q _{rr}		3.5		nC	

NOTES

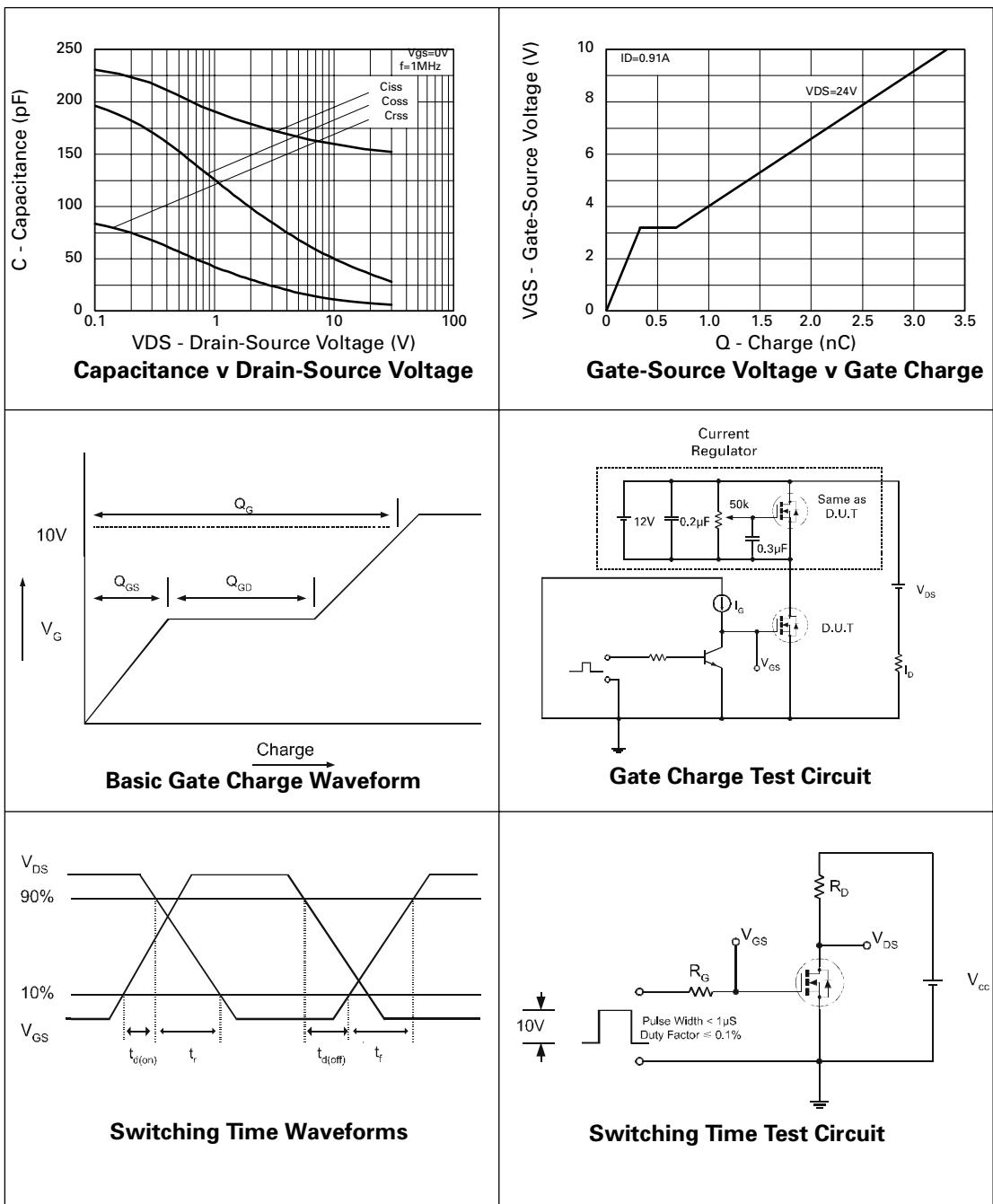
- (1) Measured under pulsed conditions. Width≤300μs. Duty cycle ≤2% .
- (2) Switching characteristics are independent of operating junction temperature.
- (3) For design aid only, not subject to production testing.

TYPICAL CHARACTERISTICS



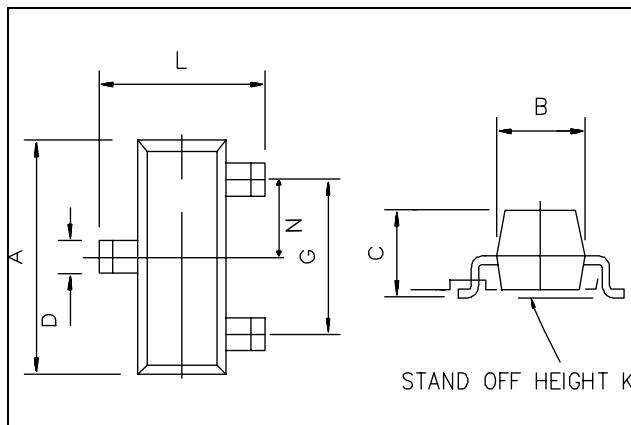
ZXM61N03F

TYPICAL CHARACTERISTICS

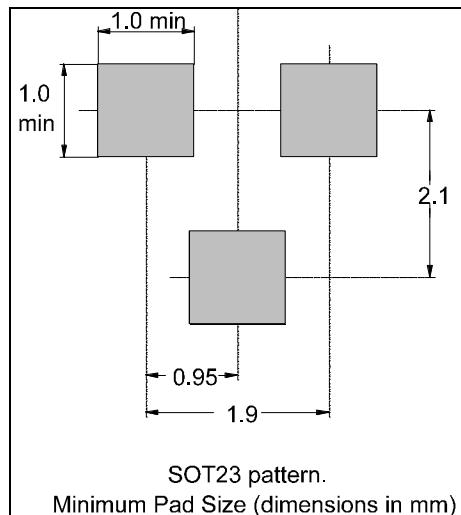


ZXM61N03F

PACKAGE DIMENSIONS



PAD LAYOUT DETAILS



DIM	Millimetres		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	2.67	3.05	0.105	0.120
B	1.20	1.40	0.047	0.055
C	–	1.10	–	0.043
D	0.37	0.53	0.0145	0.021
F	0.085	0.15	0.0033	0.0059
G	NOM 1.9		NOM 0.075	
K	0.01	0.10	0.0004	0.004
L	2.10	2.50	0.0825	0.0985
N	NOM 0.95		NOM 0.037	

SOT23 pattern.
Minimum Pad Size (dimensions in mm)



ZETEX

Zetex plc.

Fields New Road, Chadderton, Oldham, OL9-8NP, United Kingdom.
Telephone: (44)161 622 4422 (Sales). (44)161 622 4444 (General Enquiries)
Fax: (44)161 622 4420

Zetex GmbH
Streifeldstraße 19
D-81673 München
Germany
Telefon: (49) 89 45 49 49 0
Fax: (49) 89 45 49 49 49

Zetex Inc.
47 Mall Drive, Unit 4
Commack NY 11725
USA
Telephone: (516) 543-7100
Fax: (516) 864-7630

Zetex (Asia) Ltd.
3510 Metroplaza, Tower 2
Hing Fong Road,
Kwai Fong, Hong Kong
Telephone:(852) 26100 611
Fax: (852) 24250 494

These are supported by
agents and distributors in
major countries world-wide
©Zetex plc 1999
Internet:<http://www.zetex.com>

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.